

치소는, LCD드라이버의 핀피치 제품의 대응을 가능하게 하기 위해 각공정최신의 장치를 도입하여 Wafer 뱀프/Wafer 전기 테스트/COF조립/파이널 테스트의 일관 공정을 구축하고, 항상 사용자만족을 주로하고 있습니다.

금속성 뱀프

LSI (대규모집적 회로)의 배선을 외부에 꺼내는 전극으로서 사용되어지는 뱀프의 제조 기술은, 화학기술을 구사하고, 고신뢰성의 실현에 즈음하여, 강력한 백업의 역할을 다하고 있습니다.



Bump Clean Room



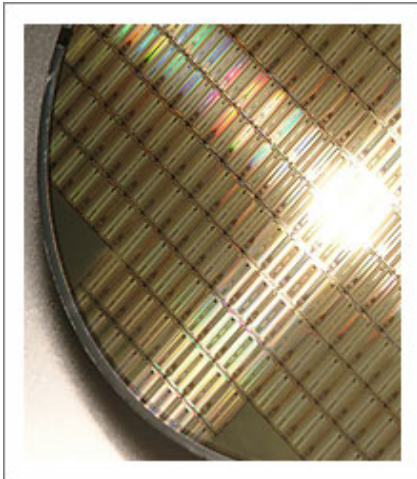
Gold Bump

Wafer 테스트

LCD 드라이버의 화인 프로세스화에 의해 많은 핀피치 제품의 안정이 요구되어 있지만, 치소의 Wafer 테스트 장치, 기술은 높은 신뢰성을 가지고 Wafer의 특성이상의 불량품 생산을 방지하고 있습니다.



Wafer Tester



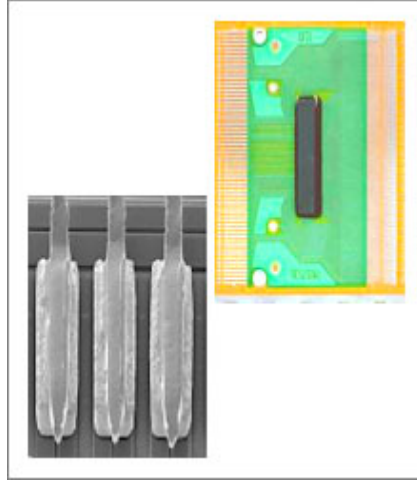
Bumped Wafer

COF 어셈블리

퍼스널 컴퓨터 화면이나 액정 텔레비전의 대형화에 따르고, 보다좋은 화질이 시장에서 요청되어, TCP 의 차세대설치 방식으로서 COF이라고 하는 조립 설치가 개발되어, 이후로의 고정밀 화면용 부품으로서 기대를 확립하고 있습니다.



Assembly Clean Room



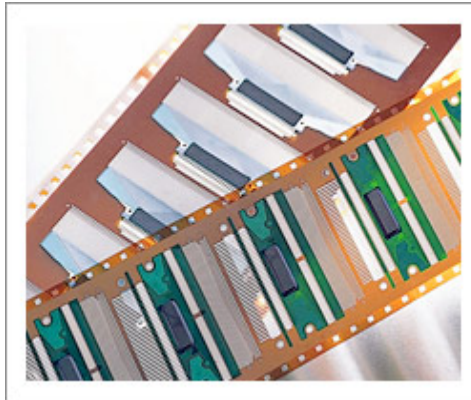
COF Bonding

파이널 테스트

Wafer 테스트와 같이 다량의 피치의 LCD드라이버를 조립해 종료후 패키지 상태인채로 전기 특성의 검사를 실시하고, 불량품의 유출을 미연에 방지하고, 많은 유저의 여기저기에게서 높은 신뢰를 얻고 있습니다.



Final Tester



Final Goods